

Solder ball placement system BU-560s (NEW)



10sec內完成錫球模具
與BGA模具規格換模

錫球模具+鋼板固定座



主模內模



少量多樣快速換模BU-560s機種

主模治具



品名:錫球植入機
(封裝廠專用機種)NEW

型式:BU-560

錫球規格:使用錫球範圍 12mil- 30mil

外部尺寸: 90cm(L)×46cm(W)×53cm(H)

重量: 32kg

使用電壓: AC-220V50/60HZ

使用SIZE: BGA最大有效使用範圍規格40mm×60mm

威達誠實業有限公司